

電気情報工学科・大学院システム情報科学府  
が主催する半導体関連  
海外インターンシップの紹介

2024年4月15日

# 本日の内容

- 1.2024年度海外インターンシップの一覧紹介
- 2.米国インターンシップ公募案内 -----湯浅
- 3.2023年度米国インターンシップ参加者の体験報告---M1大津山くん
- 4.台湾 各種インターンシップ案内 -----白谷先生

# 本日紹介する半導体関連の海外インターンシップ 一覧

インターンシップ名	滞在場所	渡航期間	負担金額	申込締切
UPWARDS	米国NY州 ◆Rochester Institute of Technology ◆企業訪問	8/8発-8/28帰国 8/9-23  8/26（調整中）	九大旅費規程でカバーされない分（別紙参照）	5/8
陽明交通大学	台湾	別紙参照	手当てあり（別紙参照）	適宜
TSMC	台湾	1. 夏 2. 随時	手当てあり（別紙参照）	1. 4/15 2. 随時
CMSC	台湾	別紙参照	手当てあり（別紙参照）	適宜
その他 企業	台湾	別紙参照	随時案内	適宜

## 全体窓口の連絡

全体窓口： 価値創造型半導体人材育成センター

<https://ecsvc.ed.kyushu-u.ac.jp/>

全体問合せ先： 価値創造型半導体人材育成センター事務局

[class\\_program@ecsvc.ed.kyushu-u.ac.jp](mailto:class_program@ecsvc.ed.kyushu-u.ac.jp)

### メールを送る際の注意

- ・ **件名**に【インターン】【参加希望の国名】を入れてください。
- ・ 本文に氏名(フルネーム)を記入ください。
- ・ 本文に学籍番号を記入してください。